

成都宏科电子科技有限公司

全自动填孔机项目比选公告

成都宏科电子科技有限公司作为比选人，根据工作需要，通过公开比选方式确定全自动填孔机项目的比选申请人。现将有关事宜告知如下：

一、项目名称

全自动填孔机。

二、项目基本情况

（一）项目名称

全自动填孔机。

（二）项目预算

88.38 万元。

（三）项目内容

采购 1 台全自动填孔机，设备用于陶瓷封装外壳产品生瓷膜片的填孔。

（四）交货期限

3.5 个月。

三、比选申请人资格要求

1.参加本项目的比选申请人应当具备以下规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加本次比选活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 未因重大执业质量等问题受到行政主管部门通报或行业协会严重处理;

(6) 信誉要求: 未处于财产被接管、冻结、破产状态, 未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间;

(7) 法律、法规规定的其他条件;

2. 本项目提出的特定资格条件:

近3年(2023年1月1日至比选申请文件递交截止之日)
比选申请人具有1个类似业绩。类似业绩是指提供给不同客户, 具有相同功能, 但不限于相同型号的产品销售, 并提供相应的合同(合同应体现甲乙双方盖章页、签订时间、货物名称等主要内容, 否则不予认可)

注: 以上资料需加盖单位鲜章。

3. 本项目 接受 / 不接受联合体参加比选。

四、报名及比选文件的获取

2026年5月29日至2026年6月4日09:00-17:00 (北京时间) 在四川能源天府阳光采购服务平台 (<http://scny.tfygcfw.com/>) 上获取。比选人不提供文件获取的其他方式。

五、比选申请文件递交时间及地址

1. 比选申请文件为 1 套正本, 2 套副本 (副本可打印或采用正本的复印件) 及比选申请文件的电子版 (U 盘, 与



正本内容一致) 1 套。

2.比选申请文件须在密封后于 2026 年 6 月 5 日 10:00 时前报送至本项目开标室:

成都宏科电子科技有限公司本部成都经济技术开发区(龙泉驿)星光中路 20 号

六、发布公告的媒介

本公告在: 成都宏科电子科技有限公司(<http://www.chinahongke.com/>)、成都宏明电子股份有限公司(<http://www.chinahongming.com>)、天府阳光采购服务平台(<https://www.tfygcgfw.com/>)上发布。

七、联系方式:

比选人: 成都宏科电子科技有限公司

地址: 成都经济技术开发区(龙泉驿)星光中路 20 号

联系人: 李老师

电 话: 028-84847220

特别提示: 1、比选人公示的联系方式作为本项目取得比选文件的唯一渠道, 请各位潜在比选申请人注意辨别, 谨防假冒、欺诈。因错信非公示联系方式导致的损失, 比选人概不承担。

2、比选申请人应在比选期间适时关注上述网站, 并及时下载相关内容, 比选人不再另行通知。如有问题或疑问, 应及时与比选人联系; 逾期未联系的, 比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问, 并视为已收到或默认已收到, 由此造成的一切后果由比选申请人自行承担。

